

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 447 868 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **91103276.1**

(51) Int. Cl.⁵: **G03F 7/039**

(22) Anmeldetag: **05.03.91**

(30) Priorität: **13.03.90 DE 4007924**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
25.09.91 Patentblatt 91/39

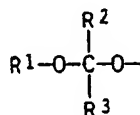
(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
W-6700 Ludwigshafen(DE)

(72) Erfinder: **Nguyen, Kim, Son, Dr.**
Zedernweg 9
W-6944 Hemsbach(DE)

(54) **Strahlungsempfindliches Gemisch.**

- (57) Die Erfindung betrifft ein strahlungsempfindliches Gemisch, im wesentlichen bestehend aus
- (a) einem in Wasser unlöslichen, in wäßrig-alkalischen Lösungen löslichen Bindemittel oder Bindemittelgemisch, und
 - (b) einer bei Bestrahlung eine starke Säure bildenden Verbindung, wobei Komponente (a) ein phenolisches Harz ist, dessen phenolische Hydroxylgruppen teilweise durch Gruppierungen (I)



(I),

worin R¹ für Alkyl und

R² und R³ für Wasserstoff oder Alkyl stehen oder R¹ mit R² einen Ring bildet, ersetzt sind.

Dieses strahlungsempfindliche Gemisch eignet sich zur Herstellung von Reliefstrukturen.

EP 0 447 868 A1

Die Erfindung betrifft positiv arbeitende strahlungsempfindliche Gemische, die ein in Wasser unlösliches, in wäßrig-alkalischen Lösungen lösliches Bindemittel und eine unter Einwirkung von Strahlung eine Säure bildende Verbindung, enthalten, wobei das Bindemittel bestimmte Gruppierungen enthält, die durch säurekatalytische Einwirkung verseift werden, wodurch die Alkalilöslichkeit des Gemisches erhöht wird.

5 Diese Gemische sind sensitiv gegenüber UV-, Elektronen- und Röntgenstrahlen und eignen sich besonders als Resistmaterial.

Positiv arbeitende strahlungsempfindliche Gemische sind bekannt und besonders positiv arbeitende Resistmaterialien, die o-Chinondiazide in wäßrig-alkalisch löslichen Bindemitteln, z.B. Novolaken oder Poly-(p-vinylphenol)en, enthalten, werden kommerziell eingesetzt. Die Empfindlichkeit dieser Systeme gegenüber

10 Strahlung, insbesondere kurzwelliger Strahlung, ist jedoch teilweise unbefriedigend.

Empfindlichkeitserhöhungen in strahlungsempfindlichen Systemen, die in der Primärphotoreaktion eine Spezies erzeugen, die dann unabhängig von der Strahlung eine katalytische Sekundärreaktion auslöst, sind beschrieben. So sind in der US-A 3,915,706 beispielsweise Photoinitiatoren beschrieben, die eine starke Säure erzeugen, die dann in einer Sekundärreaktion säurelabile Gruppen, wie Polyaldehydgruppierungen

15 spalten.

Weiterhin sind strahlungsempfindliche Gemische auf Basis von säurespaltbaren Verbindungen bekannt, die als Bindemittel ein wäßrig-alkalisch lösliches Polymer sowie eine Verbindung, die photochemisch eine starke Säure bildet, und eine weitere Verbindung mit durch Säure spaltbaren Bindungen, die durch die Einwirkung der Säure ihre Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler erhöhen, enthalten (vgl. DE-A 3 406

20 927). Als photochemisch eine starke Säure bildende Verbindungen werden Diazonium-, Phosphonium-, Sulfonium- und Iodonium-, sowie Halogenverbindungen genannt. Die Verwendung dieser Oniumsalze als photochemische Säurespender in Resistmaterialien ist z.B. auch aus US-A 4,491,628 bekannt. Einen Überblick über die Anwendung von Oniumsalzen in Resistmaterialien gibt Crivello in Org. Coatings and Appl. Polym. Sci., 48, p. 65-69 (1985).

25 Strahlungsempfindliche Gemische von Polymeren mit säurelabilen Seitengruppen und photochemischen Säurespendern sind z.B. aus US-A 4,491,628 und FR-A 2,570,844 bekannt. Diese polymeren Bindemittel sind jedoch hydrophob und werden erst nach der Belichtung alkalilöslich.

Copolymeren mit phenolischen und säurelabilen Gruppen, wie beispielsweise Poly-(p-hydroxystyrol-co-t-butoxycarbonyloxystyrol), sind aus J. Polym. Sci., Part A, Polym. Chem. Ed., Vol. 24, 2971-2980 (1986)

30 bekannt. Verwendet man jedoch diejenigen Copolymeren dieser Gruppe, die noch alkalilöslich sind, in Verbindung mit den kommerziellen Sulfoniumsalzen, wie Triphenylsulfoniumhexafluoroarsenat, wie auch in US-A 4,491,628 beschrieben, so haben diese Gemische den Nachteil, daß ein sehr hoher Abtrag der unbelichteten Bereiche stattfindet, da die genannten Sulfoniumsalze nicht genügend zur Löslichkeitsinhibierung beitragen.

35 In der DE-A 37 21 741 werden strahlungsempfindliche Gemische beschrieben, die ein in wäßrig-alkalischen Lösungen lösliches polymeres Bindemittel enthalten sowie eine organische Verbindung, deren Löslichkeit in einem wäßrig-alkalischen Entwickler durch Einwirkung von Säure erhöht wird und die mindestens eine durch Säure spaltbare Gruppierung enthält, wobei diese organische Verbindung unter Einwirkung von Strahlung eine starke Säure erzeugt.

40 Aus der DE-C 23 06 248 ist ein durch Belichten löslich werdendes Stoffgemisch und ein lichtempfindliches Aufzeichnungsmaterial bekannt, das ein phenolisches Bindemittel, einen photoaktiven Säurespender (halogenhaltiges s-Triazinderivat oder Diazoniumsalz) und ein Reaktionsprodukt einer mindestens eine Alkylvinylethergruppe enthaltenden organischen Verbindung mit einem ein- oder mehrwertigen Phenol, d.h. ein Dreikomponentensystem enthält. Diese Systeme weisen jedoch zu geringe thermische Stabilität auf und

45 ergeben Struktureigenschaften, die sie für den Submikronbereich ungeeignet machen.

Aus CA Selects: Photoresist, Issue 1, 1990, 244016m ist Polyhydroxystyrol, dessen Hydroxylgruppen durch Tetrahydropyranyl- und Tetrahydrofuranylegruppen geschützt sind, und das mit bis(tert.-butylphenyl)-jodoniumtriflat kombiniert wird, bekannt. Ebenso ist aus PME 1989 (= Polymers for Microelectronics-Science and Technology), Seiten 66-67 Polyhydroxystyrol, dessen OH-Gruppen teilweise durch Tetrahydropyranylgruppen ersetzt sind, in Kombination mit Triphenylsulfoniumtriflat bekannt. Nachteilig bei den beiden

50 zuletzt genannten Systemen ist, daß sie bei Überbelichtung nicht mehr positiv, sondern negativ arbeitend sind, was ihre Anwendbarkeit stark einschränkt.

In der US-A 4 101 323 sind strahlungsempfindliche Kopiermassen beschrieben, die Bindemittel, die in der Hauptkette säurespaltbare -C-O-C-Gruppierungen enthalten, sowie eine Polychlorverbindung als Säurespender enthalten. In EP-A 302 359 sind strahlungsempfindliche Kopiermassen beschrieben, die ein Dreikomponentensystem aus alkalilöslichem phenolischem Bindemittel, einer Polychlorverbindung als Säurespender und einer Verbindung mit zwei Acetalgruppen als Inhibitor enthalten. Während die in oben

55 genannter US-Patentschrift beschriebenen Kopiermassen ungenügende Reproduzierbarkeit bei ihrer Her-

stellung aufweisen, ergeben sich bei den in der EP-A beschriebenen Kopiermassen die bereits oben genannten Nachteile der Dreikomponentensysteme.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, neue positiv arbeitende hochaktive strahlungsempfindliche Systeme für die Herstellung von Reliefstrukturen aufzuzeigen, die sich mit wäßrig-alkalischen Lösungen entwickeln lassen und die Herstellung von im kurzwelligen UV lichtempfindlichen Schichten ermöglichen.

Dazu soll ein strahlungsempfindliches Gemisch, das ein in Wasser unlösliches, in wäßrig-alkalischer Lösung lösliches Bindemittel mit einer säurelabilen Gruppierung, die durch Einwirkung von Säure verseift wird, und eine bei Bestrahlung eine starke Säure bildende Verbindung enthält, bildmäßig bestrahlt, erwärmt und die bildmäßig bestrahlten Schichtbereiche mit Entwicklerlösung ausgewaschen werden.

Überraschenderweise wurde gefunden, daß durch den Ersatz von 20 bis 70 % der phenolischen Hydroxylgruppen des Bindemittels durch bestimmte Acetalgruppierungen hochaktive strahlungsempfindliche Systeme für die Herstellung von Reliefstrukturen im kurzwelligen UV erhalten werden, die sich besonders durch sehr gute Reproduzierbarkeit und hohe Auflösung auszeichnen.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein strahlungsempfindliches Gemisch, im wesentlichen bestehend aus

(a) einem in Wasser unlöslichen, in wäßrig-alkalischen Lösungen löslichen Bindemittel oder Bindemittelgemisch und

(b) einer bei Bestrahlung eine starke Säure bildenden Verbindung, das dadurch gekennzeichnet ist, daß Komponente (a) ein phenolisches Harz ist, dessen phenolische Hydroxylgruppen zu 20 bis 70 % durch Gruppierungen (I)



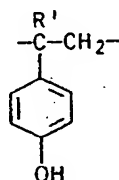
worin

R¹ für Alkyl steht,
R² für Alkyl steht und
R³ für Wasserstoff oder Alkyl steht,

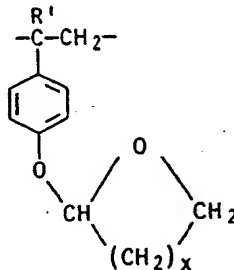
oder R¹ zusammen mit R² über (CH₂)_m mit m = 3 bis 6 einen Ring bildet, ersetzt sind.

Als Komponente (a) können Poly-(p-hydroxystyrol) oder Poly-(p-hydroxi-α-methylstyrol) mit mittleren Molekulargewichten \bar{M}_w zwischen 200 und 200 000 eingesetzt werden, wobei 20 bis 70 %, vorzugsweise 25 bis 60 % der phenolischen Hydroxylgruppen durch die Gruppierung (I) ersetzt sind.

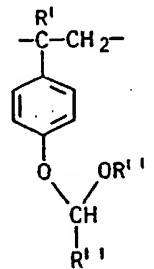
Bevorzugt als Bindemittel-Komponente (a) sind solche, die Gruppierungen (II) und (III) oder (II) und (IV)



(II)



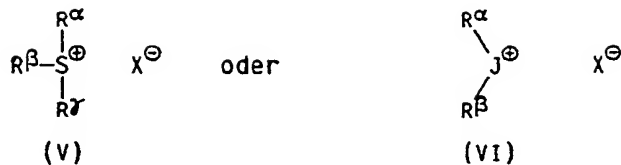
(III)



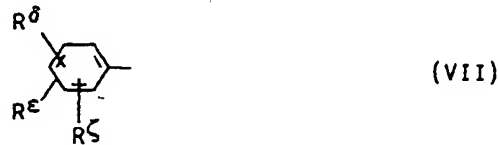
(IV)

enthalten, wobei x = 2 oder 3 ist, R¹ für H oder CH₃ steht, R^{1''} und R^{1'''} untereinander gleich oder verschieden sind und für Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen stehen, wie die Copolymerisate aus p-Hydroxystyrol und 2-Tetrahydropyranoxystyrol oder 2-Tetrahydrofuranoxystyrol - wobei diese Copolymerisate auch durch polymeranaloge Umsetzung hergestellt sein können -

Als Komponente (b) enthalten die erfindungsgemäßen strahlungsempfindlichen Gemische vorzugsweise Sulfonium- oder Jodoniumsalze der allgemeinen Formeln (V) oder (VI),



worin R^α , R^β und R^γ untereinander gleich oder verschieden sind und für Alkyl mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, Aryl, substituiertes Aryl oder Aralkyl stehen und $X^- = ClO_4^-, AsF_6^-, SbF_6^-, PF_6^-, BF_4^-, CH_3SO_3^-$ und/oder $CF_3SO_3^-$ ist, insbesondere solche, in denen mindestens einer der Reste R^α, R^β und R^γ für einen Rest der allgemeinen Formel (VII)



steht, worin R^δ , R^ϵ und R^ζ untereinander gleich oder verschieden sind und für H, OH, Halogen, Alkyl, Acyloxi oder Alkoxi mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen stehen.

Die erfindungsgemäßen strahlungsempfindlichen Gemische enthalten Komponente (a) im allgemeinen in einer Menge von 80 bis 99 Gew.-% und Komponente (b) in einer Menge von 1 bis 20 Gew.-%.

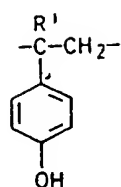
Die erfindungsgemäßen Gemische können zusätzlich Sensibilisatoren enthalten, die Strahlung absorbieren und auf Komponente (b) übertragen, bzw. zusätzlich bis zu 1 Gew.-% eines Haftvermittlers, Tensids oder Farbstoffs.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung lichtempfindlicher Beschichtungsmaterialien, wobei erfindungsgemäße strahlungsempfindliche Gemische eingesetzt werden, sowie ein Verfahren zur Herstellung von Reliefstrukturen durch Auftragen eines strahlungsempfindlichen Gemisches in einer Schichtdicke von 0,1 bis 5 μm auf ein in üblicher Weise vorbehandeltes Substrat, Trocknen bei Temperaturen von 70 bis 130 °C, bildmäßiges Belichten, gegebenenfalls Erhitzen auf Temperaturen von 70 bis 160 °C, und Entwickeln mit einer wäßrig-alkalischen Lösung, wobei erfindungsgemäße strahlungsempfindliche Gemische eingesetzt werden.

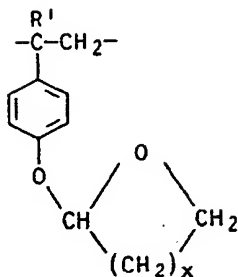
Das erfindungsgemäße System ist besonders vorteilhaft, da es sich in Kombination mit den besonders preisgünstigen Bindemitteln auf Novolak-Basis einsetzen läßt. Die damit erhaltenen Reliefstrukturen zeichnen sich durch sehr gute Reproduzierbarkeit und hohe Auflösung aus.

Zu den Aufbaukomponenten des erfindungsgemäßen strahlungsempfindlichen Gemisches ist im einzelnen folgendes auszuführen.

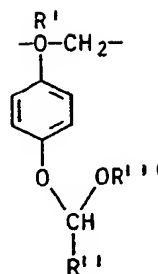
a) Als in Wasser unlösliche, in wäßrig-alkalischen Lösungen lösliche Bindemittel oder Bindemittelgemische kommen wegen der meist erforderlichen Plasmaätzstabilität phenolische Harze in Betracht, deren phenolische Hydroxylgruppen zu 20 bis 70, insbesondere 25 bis 60 % durch die Gruppierung (I) ersetzt sind, wie z.B. entsprechende Novolake mit Molekulargewichten \bar{M}_w zwischen 300 und 20.000, vorzugsweise zwischen 300 und 2000 g/mol, für Belichtung im kurzwelligen UV-Bereich (≤ 300 nm) insbesondere Novolake auf Basis p-Kresol/Formaldehyd, Poly(p-hydroxystyrole) und Poly(p-hydroxi- α -methylstyrole), wobei diese Poly(p-hydroxystyrole) im allgemeinen Molekulargewichte \bar{M}_w zwischen 200 und 200.000, vorzugsweise zwischen 1000 und 40.000 g/mol aufweisen. Diese Poly(p-hydroxystyrole) können auch in bekannter Weise durch Umsetzung (polymeranaloge Umsetzung) ihrer Hydroxylgruppen mit z.B. 3,4-Dihydropyran, Dihydrofuran, erfindungsgemäß modifiziert sein. Die so erhältlichen und im vorliegenden Falle auch als Copolymerisate verstandenen modifizierten polymeren Bindemittel (a) sind vorzugsweise solche, die im wesentlichen aus Gruppierungen (II) und (III) oder (II) und (IV) bestehen,



(II)



(III)

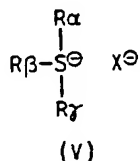


(IV)

worin $x = 2$ oder 3 ist, R' für H oder CH_3 steht, R'' und R''' untereinander gleich oder verschieden sind und für Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen stehen, d.h. Copolymerisate aus p-Hydroxystyrol und 2-Tetrahydropyranoxystyrol oder 2-Tetrahydrofuranoxystyrol - wobei diese Copolymerisate auch durch polymeranaloge Umsetzung hergestellt sein können - .

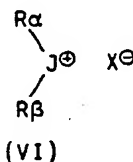
Es eignen sich auch Gemische der obengenannten Bindemittel (a). Bindemittel (a) ist im erfindungsgemäßen Gemisch im allgemeinen in Mengen von 80 bis 99, vorzugsweise 90 bis 97 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge des strahlungsempfindlichen Gemisches (a) + (b) enthalten.

b) Als bei Bestrahlung eine starke Säure bildende Verbindungen (b) kommen im Prinzip alle Verbindungen in Frage, die diese Eigenschaft aufweisen und so als Säurespender wirksam sind. Für die Bestrahlung mit kurzwelligen UV-Strahlen sind jedoch Iodonium- und insbesondere Sulfoniumsalze bevorzugt. Diese entsprechen den allgemeinen Formeln (V) bzw. (VI)



(V)

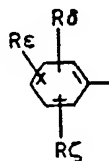
bzw.



(VI)

worin

R_α , R_β und R_γ untereinander gleich oder verschieden sind und für Alkyl, beispielsweise mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise Methyl oder Ethyl, Aryl, wie z.B. Phenyl oder Aralkyl, wie z.B. Benzyl, oder den Rest



stehen, worin R_δ , R_ϵ und R_ζ untereinander gleich oder verschieden sind und für Wasserstoff, OH, Halogen, wie z.B. Chlor oder Brom, Alkyl, beispielsweise mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise Methyl oder tert. Butyl, Acyloxi, wie z.B. Acetoxy oder Propionyloxy oder Alkoxi, beispielsweise mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise Methoxy oder tert. Butoxy, stehen und $\text{X}^+ = \text{AsF}_6^+$, SbF_6^+ , PF_6^+ , BF_4^+ , CH_3SO_3^+ , ClO_4^+ oder CF_3SO_3^+ ist.

Beispiele für besonders gut geeignete Komponenten (b) sind Triphenylsulfoniumsalze und Diphenyliodoniumsalze, Tris(4-hydroxyphenyl)sulfoniumsalz, Tris(4-ethyloxycarbonyloxyphenyl)sulfoniumsalz, jeweils mit $\text{X}^- = \text{ClO}_4^-$, AsF_6^- , PF_6^- , SbF_6^- , BF_4^- , CH_3SO_3^- und/oder CF_3SO_3^- als Gegenionen.

Auch Gemische der unter (b) genannten Verbindungen können eingesetzt werden. Komponente (b) ist im erfindungsgemäßen strahlungsempfindlichen Gemisch im allgemeinen in Mengen von 1 bis 20, vorzugsweise 3 bis 10 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmenge des strahlungsempfindlichen Gemisches (a) + (b), enthalten.

Das erfindungsgemäße strahlungsempfindliche Gemisch kann zusätzlich noch weitere übliche Hilfs- und Zusatzstoffe enthalten.

Die erfindungsgemäßen Gemische werden bevorzugt in einem organischen Lösungsmittel gelöst,

wobei der Feststoffgehalt im allgemeinen im Bereich zwischen 5 und 40 Gew.% liegt. Als Lösungsmittel kommen bevorzugt aliphatische Ketone, Ether und Ester, sowie Mischungen derselben in Frage. Besonders bevorzugt sind Alkylenglykol-monoalkylether, wie beispielsweise Ethyl-cellosolve, Butylglykol, Methyl-cellosolve und 1-Methoxy-2-propanol, Alkylenglykol-alkylether-ester, wie beispielsweise Methyl-cellosolve-acetat, Ethyl-cellosolve-acetat, Methyl-propylenglykol-acetat und Ethyl-propylenglykol-acetat, Ketone, wie beispielsweise Cyclohexanon, Cyclopentanon und Methyl-ethyl-keton, sowie Acetate wie Butylacetat und Aromaten, wie Toluol und Xylol. Die Auswahl der entsprechenden Lösungsmittel, sowie deren Mischung richtet sich nach der Wahl des jeweiligen phenolischen Polymers, Novolaks und der photoempfindlichen Komponente.

Weiterhin können andere Zusätze wie Haftvermittler, Netzmittel, Farbstoffe und Weichmacher zugesetzt werden, im allgemeinen in Mengen von bis zu 1 Gew.-%.

Gegebenenfalls können auch Sensibilisatoren in geringen Mengen zugesetzt werden, um die Verbindungen im längerwelligen UV- bis hin zum sichtbaren Bereich zu sensibilisieren. Polycyclische Aromaten, wie Pyren und Perylen sind hierfür bevorzugt, jedoch können auch andere Farbstoffe, die als Sensibilisatoren wirken, verwendet werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung von Reliefmustern wird eine strahlungsempfindliche Aufzeichnungsschicht, die im wesentlichen aus dem erfindungsgemäßen strahlungsempfindlichen Gemisch besteht, bildmäßig in solcher Dosis bestrahlt, daß die Löslichkeit der belichteten Bereiche in wäßrig-alkalischen Lösungsmitteln zunimmt und diese bestrahlten Bereiche selektiv mit dem alkalischen Entwickler entfernt werden können.

Besondere Vorteile der erfindungsgemäßen strahlungsempfindlichen Gemische sind die damit erhältlichen sehr guten Struktureigenschaften (sehr steile Kanten, saubere Strukturen).

Die das erfindungsgemäße strahlungsempfindliche Gemisch enthaltenden Photoresistlösungen werden im allgemeinen in Schichtdicken von 0,1 bis 5 μm vorzugsweise 0,5 bis 1,5 μm auf geeignete Substrate, beispielsweise oberflächlich oxidierte Silizium-Wafer durch Aufschleudern (spin coating) aufgetragen, getrocknet (z.B. bei Temperaturen zwischen 70 und 130 °C) und mit einer geeigneten Lichtquelle durch eine Photomaske bildmäßig belichtet. Als Lichtquellen eignen sich insbesondere kurzwellige UV-Strahlen (deep UV) mit Wellenlängen zwischen 200 und 300 nm. Besonders geeignete Lichtquellen sind Excimer-Laser von KrF (248 nm). Nach dem bildmäßigen Belichten wird - gegebenenfalls nach kurzem Ausheizen (postbake) bei Temperaturen bis zu 150 °C - mit üblichen wäßrig-alkalischen Entwicklerlösungen - im allgemeinen bei pH-Werten zwischen 12 und 14 - entwickelt, wobei die belichteten Stellen ausgewaschen werden. Die Auflösung liegt im Submikron-Bereich. Die für die erfindungsgemäßen strahlungsempfindlichen Gemische benötigte Belichtungsenergie liegt im allgemeinen zwischen 50 und 300 mJ/cm² bei Schichtdicken von 1 μm .

Die in den Beispielen angegebenen Teile und Prozente sind, soweit nicht anders angegeben, Gewichtssteile bzw. Gewichtsprozente.

Die Herstellung der phenolischen Harze (a), deren phenolische Hydroxylgruppen teilweise durch Gruppierung (I) ersetzt sind, kann analog der in Helv. Chim. Acta 46, 415 (1963) gegebenen-Vorschrift erfolgen.

Beispiel für die Herstellung von Poly(p-hydroxystyrol), dessen phenolische Hydroxylgruppen teilweise durch 2-Tetrahydropyranyl-gruppen geschützt sind:

10 Teile Poly(p-hydroxystyrol) (MG = 10.000) und 11 Teile 3,4-Dihydropyran werden in 90 Teilen Essigester aufgelöst; danach werden unter N₂-Atmosphäre 0,15 Teile konz. HCl (36%ige Lösung) zugegeben und bei Raumtemperatur so lange gerührt, bis das IR-Spektrum der Lösung identisch ist mit dem der Lösung des Gemisches aus Poly(p-hydroxystyrol) und 2-Tetrahydropyranyl-4-ethylphenylether (Verhältnis 1:1); d.h. 50 % der phenolischen OH-Gruppen sind durch Tetrahydropyranylgruppierungen geschützt. Das so erhaltene Produkt wird in 1.500 Teilen Ligroin gefällt, abgesaugt und bei 50 °C unter Vakuum getrocknet. Das IR-Spektrum des Produkts nach dem Trocknen zeigt, daß etwa 50 % der OH-Gruppen durch Tetrahydropyranylgruppen geschützt sind.

Beispiel 1

Eine Photoresistlösung wird aus 95 Teilen eines, wie oben angegeben, aus Poly(p-hydroxystyrol) mit einem mittleren Molekulargewicht \bar{M}_w von 10.000 hergestellten Produkts, dessen phenolische Hydroxylgruppen zu 50 % durch 2-Tetrahydropyranylgruppen geschützt sind, 5 Teile Triphenylsulfoniumhexafluoroarsenat und 250 Teilen Ethylenglykol-monomethyletheracetat hergestellt.

Die Lösung wird anschließend durch ein Filter mit einem Porendurchmesser von 0,2 μm filtriert.

Die Resistlösung wird auf einen Siliciumwafer, der mit Hexamethyldisilazan als Haftvermittler überzogen ist, mit 4000 Upm/30 Sekunden aufgeschleudert, wobei eine Schichtdicke von etwa 1 μm erhalten wird. Der

Wafer wird während 3 Minuten auf einer Heizplatte bei 80 °C getrocknet, anschließend mit einer bildmäßig strukturierten Testmaske in Kontakt gebracht und mit einem Excimer-Laser ($\lambda = 248 \text{ nm}$, $E = 35 \text{ mW/cm}^2$) belichtet. Danach wird der Wafer 1 Minute bei 80 °C ausgeheizt und mit einem Entwickler vom pH-Wert 12,0-13,6 entwickelt. Die Lichtempfindlichkeit beträgt 80 mJ/cm².

5 Es ist kein Dunkelabtrag (= Schichtdickenverlust der unbelichteten Stellen nach der Entwicklung) feststellbar.

Vergleichsbeispiel 1

10 Es wird wie in Beispiel 1 beschrieben, jedoch unter Ersatz der 95 Teile Poly(p-hydroxystyrol), dessen phenolische Hydroxylgruppen zu 50 % durch 2-Tetrahydropyranylgruppen geschützt sind, durch 95 Teile Poly(p-hydroxystyrol), dessen phenolische Hydroxylgruppen nur zu 15 % durch 2-Tetrahydropyranylgruppen geschützt sind, eine Photoresistlösung hergestellt und weiterverarbeitet. Die Lichtempfindlichkeit beträgt in diesem Falle 65 mJ/cm², der Dunkelabtrag jedoch etwa 20 %, was nicht mehr akzeptabel ist.

15 Vergleichsbeispiel 2

Es wird wie in Beispiel 1 beschrieben, jedoch unter Ersatz der 95 Teile Poly(p-hydroxystyrol), dessen phenolische Hydroxylgruppen zu 50 % durch 2-Tetrahydropyranylgruppen geschützt sind, durch 95 Teile
20 Poly(p-hydroxystyrol), dessen phenolische Hydroxylgruppen zu 80 % durch 2-Tetrahydropyranylgruppen geschützt sind, eine Photoresistlösung hergestellt und weiterverarbeitet. Der so erhaltene Resist erweist sich bei einer Lichtempfindlichkeit von 100 mJ/cm² als positiv arbeitend, bei einer Lichtempfindlichkeit von 150 mJ/cm² als negativ arbeitend, d.h. mit starker Restschichtbildung.

25 Beispiel 2

Es wird wie in Beispiel 1 beschrieben, jedoch unter Ersatz der 5 Teile Triphenylsulfoniumhexafluoroarsenat durch 5 Teile Diphenyljodoniumhexafluorophosphat eine Photoresistlösung hergestellt und weiterverarbeitet. Die Lichtempfindlichkeit beträgt 270 mJ/cm².

30 Beispiel 3

Es wird wie in Beispiel 1 beschrieben, jedoch unter Ersatz der 5 Teile Triphenylsulfoniumhexafluoroarsenat durch 5 Teile Tris(4-hydroxyphenyl)sulfoniumtriflat eine Photoresistlösung hergestellt und weiterverarbeitet. Die Lichtempfindlichkeit beträgt 90 mJ/cm².

Beispiel 4

Es wird wie in Beispiel 3 beschrieben eine Photoresistlösung hergestellt und weiterverarbeitet, doch
40 wird nach dem Belichten nicht bei 80 °C ausgeheizt, d.h. ohne postbake gearbeitet. Die Lichtempfindlichkeit beträgt 130 mJ/cm².

Beispiel 5

45 Es wird, wie in Beispiel 3 beschrieben, eine Photoresistlösung hergestellt und weiterverarbeitet, doch wird nach dem Belichten nicht bei 80 °C, sondern bei 120 °C ausgeheizt. Die Lichtempfindlichkeit beträgt 60 mJ/cm².

Beispiel 6

50 Es wird, wie in Beispiel 3 beschrieben, eine Photoresistlösung hergestellt, jedoch werden anstatt 95 Teilen 97 Teile Poly(p-hydroxystyrol), dessen phenolische Hydroxylgruppen zu 50 % durch 2-Tetrahydropyranylgruppen geschützt sind, und anstatt 5 Teilen 3 Teile Tris(4-hydroxyphenyl)sulfoniumtriflat eingesetzt. Die Weiterverarbeitung erfolgt wie in Beispiel 1 beschrieben. Die Lichtempfindlichkeit beträgt 100 mJ/cm².

55

Patentansprüche

1. Strahlungsempfindliches Gemisch, im wesentlichen bestehend aus

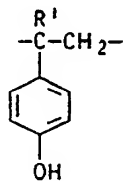
- (a) einem in Wasser unlöslichen, in wäßrig-alkalischen Lösungen löslichen Bindemittel oder Bindemittelgemisch und
 (b) einer bei Bestrahlung eine starke Säure bildenden Verbindung,
 dadurch gekennzeichnet, daß Komponente (a) ein phenolisches Harz ist, dessen phenolische Hydroxylgruppen zu 20 bis 70 % durch Gruppierungen (I)



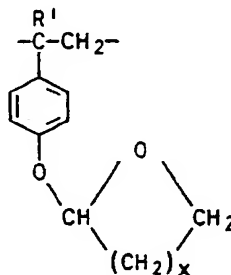
worin

- R¹ für Alkyl steht,
 R² für Alkyl steht und
 R³ für Wasserstoff oder Alkyl steht,
 oder R¹ zusammen mit R² über -(CH₂)_m- mit m = 3 bis 6 einen Ring bildet, ersetzt sind.

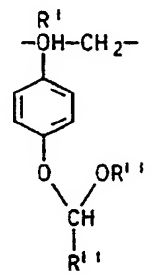
2. Strahlungsempfindliches Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (a) ein Gemisch aus einem phenolischem Harz und einem davon verschiedenen Novolak eingesetzt wird.
3. Strahlungsempfindliches Gemisch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (a) Poly-(p-hydroxystyrol) oder Poly-(p-hydroxi-α-methylstyrol) mit mittleren Molekulargewichten \bar{M}_w zwischen 200 und 200 000 eingesetzt wird, wobei 20 bis 70 % der Hydroxylgruppen durch die Gruppierung (I) ersetzt sind.
4. Strahlungsempfindliches Gemisch nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Komponente (a) Gruppierungen (II) und (III) oder (II) und (IV)



(II)



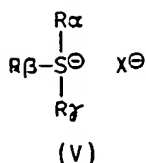
(III)



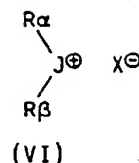
(IV)

enthält, wobei x = 2 oder 3 ist, R¹ für H oder CH₃ steht, R^{1''} und R^{1'''} untereinander gleich oder verschieden sind und für Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen stehen.

5. Strahlungsempfindliches Gemisch nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Bindemittel (a) ein Copolymerisat aus p-Hydroxystyrol und 2-Tetrahydropyranyloxystyrol oder 2-Tetrahydrofuranyloxystyrol - wobei diese Copolymerisate auch durch polymeranaloge Umsetzung hergestellt sein können - eingesetzt wird.
6. Strahlungsempfindliches Gemisch nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (b) ein Sulfonium- oder Jodoniumsalz der allgemeinen Formeln (V) oder (VI)



bzw.



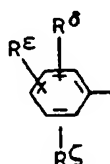
5

10

eingesetzt wird, worin $R\alpha$, $R\beta$ und $R\gamma$ untereinander gleich oder verschieden sind und für Alkyl mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen, Aryl, substituiertes Aryl oder Aralkyl stehen und $X^{\ominus} = ClO_4^{\ominus}$, AsF_6^{\ominus} , SbF_6^{\ominus} , PF_6^{\ominus} , BF_4^{\ominus} , $CH_3SO_3^{\ominus}$ und/oder $CF_3SO_3^{\ominus}$ ist.

7. Strahlungsempfindliches Gemisch nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens einer der Reste $R\alpha$, $R\beta$ und $R\gamma$ für einen Rest der allgemeinen Formel (VII)

15



(VII)

20

steht, worin R^{δ} , R^{ϵ} und R^{ζ} untereinander gleich oder verschieden sind und für H, OH, Halogen, Alkyl, Acyloxi oder Alkoxi mit jeweils 1 bis 4 Kohlenstoffatomen stehen.

- 25 8. Strahlungsempfindliches Gemisch nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Komponente (a) in einer Menge von 80 bis 99 Gew.-% und Komponente (b) in einer Menge von 1 bis 20 Gew.-% enthalten ist.

30

9. Strahlungsempfindliches Gemisch nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich einen Sensibilisator enthält, der Strahlung absorbiert und auf Komponente (b) überträgt.

10. Strahlungsempfindliches Gemisch nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich bis zu 1 Gew.-% eines Haftvermittlers, Tensids oder Farbstoffe enthält.

35

11. Verfahren zur Herstellung lichtempfindlicher Beschichtungsmaterialien, dadurch gekennzeichnet, daß ein strahlungsempfindliches Gemisch gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10 eingesetzt wird.

40

12. Verfahren zur Herstellung von Reliefstrukturen durch Auftragen eines strahlungsempfindlichen Gemisches in einer Schichtdicke von 0,1 bis 5 μm auf ein in üblicher Weise vorbehandeltes Substrat, Trocknen bei Temperaturen von 70 bis 130°C, bildmäßiges Belichten, gegebenenfalls Erhitzen auf Temperaturen von 70 bis 160°C, und Entwickeln mit einer wäßrig-alkalischen Lösung, dadurch gekennzeichnet, daß ein strahlungsempfindliches Gemisch nach einem der Ansprüche 1 bis 10 eingesetzt wird.

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER
RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 10 3276

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE					
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)		
X	EP-A-0 342 498 (BASF AG) * Seite 3, Zeile 10 - Seite 4, Zeile 2; Ansprüche 1-7 * - - - -	1-12	G 03 F 7/039		
A,D	EP-A-0 297 443 (BASF AG) * das ganze Dokument & DE-A-3721741 * - - - -	1			
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 339 (P-757)(3186) 12 September 1988, & JP-A-63 097947 (KONICA CORP) 28. Januar 1988, * das ganze Dokument * - - - - -	1			
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)		
			G 03 F		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt					
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer		
Den Haag		25 Juni 91	LUDI M.M.B.		
<table border="0"><tr><td>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</td><td>E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</td></tr></table>				KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument				